

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 廣合科技

**Delton Technology (Guangzhou) Inc.**

**廣州廣合科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1989)

## 海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列廣州廣合科技股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))刊登了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

關於向全資子公司增資的公告

特此公告。

承董事會命  
廣州廣合科技股份有限公司  
董事長  
肖紅星

香港，2026年4月29日

截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事肖紅星先生、曾紅女士及彭鏡輝先生，非執行董事劉錦嬋女士及獨立非執行董事陳麗梅女士、李瑩女士及施凌博士。

**广州广合科技股份有限公司  
关于向全资子公司增资的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、本次增资情况概述**

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，本次增资情况如下：

（1）公司拟使用H股募集资金向全资子公司广合科技（国际）有限公司（以下简称“广合国际”）增资1,600万美元，用于未来寻求策略性合作、投资或收购机会。

（2）为顺利推进公司H股募集资金投资项目之泰国生产基地二期建设项目实施，公司拟使用H股募集资金向全资子公司广合国际增资8,000万美元，再通过广合国际及广合投资控股有限公司（英文名称“Delton Investment Holdings Limited”）（以下简称“广合控股”）按股权出资比例向广合科技（泰国）有限公司（英文名称“Delton Technology (Thailand) Co., Ltd”）（以下简称“泰国广合”）合计增资8,000万美元。

综上，本次增资广合国际金额为9,600万美元，增资泰国广合金额为8,000万美元，增资对象均为公司全资子公司，资金来源为公司H股募集资金，不涉及募集资金用途变更。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》等相关规定，本次增资事项属于董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。

**二、本次增资的基本情况**

（1）广合国际：

公司名称：广合科技（国际）有限公司

成立日期：2019 年 1 月 3 日

注册地址：香港铜锣湾谢斐道 408-412 号华斐商业大厦 1701-1702 室

注册资本：4,200 万美元

主营业务：从事 PCB 的销售

股权结构：公司持有 100% 股权

2025 年主要财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	189,014.82
负债总额	146,675.90
净资产	42,338.92
项目	2025 年 1-12 月（经审计）
营业收入	371,205.08
利润总额	7,310.47
净利润	6,104.24

（2）广合控股：

公司名称：Delton Investment Holdings Limited

成立日期：2023 年 4 月 4 日

注册地址：英国英属维尔京群岛托托拉岛罗德镇梅里迪安广场水边大厦 4 楼

注册资本：1 万美元

主营业务：从事投资管理业务

股权结构：公司全资子公司广合科技（国际）有限公司持有 100% 股权

2025 年主要财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	32,329.93
负债总额	32,061.82
净资产	268.11
项目	2025 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	0.00
利润总额	723.29
净利润	653.92

(3) 泰国广合:

公司名称: Delton Technology (Thailand) Co., Ltd

成立日期: 2023 年 5 月 19 日

注册地址: 888/8, 888/9 Moo 8, Bo Thong, Kabin Buri, Prachin Buri, Thailand

注册资本: 160,000.00 万泰铢

主营业务: 从事 PCB 的生产和销售

股权结构: 公司全资子公司广合科技(国际)有限公司持股 2%, 二级全资子公司广合投资控股有限公司持股 98%。

2025 年主要财务数据:

单位: 万元

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	122,271.50
负债总额	96,014.49
净资产	26,257.01
项目	2025 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	16,065.94

利润总额	-6,886.71
净利润	-5,711.28

### 三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资主要为落实公司 H 股募集资金投资项目，有助于公司把握行业整合机遇，完善产业布局，加快泰国基地二期项目建设，扩大海外高端 PCB 产能，提升公司全球市场竞争力。本次增资使用公司 H 股境外募集资金，不影响公司主营业务及现有资金使用安排，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司严格按照 H 股招股说明书及募集资金使用计划执行，未改变募集资金投向，不涉及募集资金用途变更。

### 四、备查文件

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第二届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日